

a cura di: Gian Pado Collalto - giampa - 29-07-2014 13:00

Haswell-E userà una TIM saldata



LINK (https://www.nexthardware.com/news/processori-chipset/6299/haswell-e-usera-una-tim-saldata.htm)

Intel abbandona la discutibile pasta termica di bassa qualità sulle future CPU HEDT.



Le nuove CPU top di gamma Intel Haswell-E useranno della resina epossidica saldata tra il die e l'IHS in luogo della pessima pasta termica (TIM) presente sulle attuali soluzioni Haswell, 4790K compreso.

Come riporta OCDrift (http://www.ocdrift.com/intel-core-i7-5960x-de-lidded-haswell-e-uses-soldered-thermal-interface-material-tim/), a cui facciamo i nostri complimenti per essere già riusciti a mettere le mani su uno dei nuovi processori, oltretutto il Core i7-5960X, questa è una ottima notizia per gli amanti dell'overclock, perchè tale scelta comporta una maggiore conducibilità termica.

Non a caso, l'utilizzo della comune pasta termica è stato da più parti indicato come uno dei freni maggiori all'overclock di Haswell Refresh, almeno con sistemi di raffreddamento non estremi, a causa del cattivo

contatto tra il core e la piastra metallica superiore, insieme alla presenza del regolatore di tensione completamente integrato (FVIR) che vedrà la sua scomparsa dopo l'uscita di Broadwell.

Dato il pubblico a cui sono rivolti ed il prezzo a cui saranno lanciati i nuovi Haswell-E abbinati al chipset X99, era impensabile che Intel non mettesse mano a questo evidente problema, che tanto ha fatto indispettire molti dei suoi clienti nonostante i buoni volumi di vendita ottenuti.

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esdusiva proprietà di nexthardware.com. Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disdaimer.htm